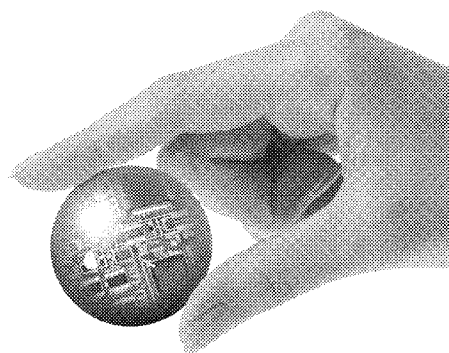


TOSHIBA
Leading Innovation >>>



組込みシステムにおけるソフトウェア開発からシステムLSI設計まで
お客様のニーズに、**素早く、柔軟に、きめ細やかに**対応

Embedded Technology 2012

パシフィコ横浜
E-07
ブース出展します



東芝情報システム株式会社

営業本部
〒210-8540 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地53
TEL:044-246-8320 FAX:044-246-8134
<http://www.tjsys.co.jp/>

東芝グループは、持続可能な
地球の未来に貢献します。

eco スタイル

組込みソフトウェアは、30年以上にわたるキャノン製品のソフトウェア開発で培ってきた技術を生かし、ソフトウェア開発から品質保証まで製品開発サイクルの幅広いニーズに対応する。

開発分野は、コンシューマー機器から事務機、産業機器の組込みソフトウェアから製品に付加価値を与えるアプリケーション開発など多岐に渡り、豊富な実績とノウハウを元に、製造業の組込みシステム開発現場に対し技術力を提供する。

またブース内にはミニシステムを設置し、同社のユニークなサービスなどを紹介する。

キャノンソフトウェア

TDKの出展テーマは「Smart Storage, Smart Entry」。効率的エネルギー活用や産業・社会システムなどが、一つの電子部品を介して「スマート」につながり、近未来型社会インフラに貢献していく決意を込めた、会場では産業用組込みmSATA対応のSSD（ソリッド・ステート・ドライブ）やコントローラICなどを展示する。SSDコントローラIC、GBDriverシリーズは1ページあたり16ギ

有力企業の製品・技術へ順不同

TDK

ROMテックは、半導体メモリへのプログラミング（書き込み）という企業概念のもと、創業27年の伝統と豊富な実績を持つ。同社が、データ書き込みなどの付加価値を加えて製品化した半導体メモリは、自動車デジタル家電、携帯電話、ロボット、PC、医療機器など、私たちの生活に欠かせない分野で活躍している。

「半導体業界のレスキュー」として、書き込みに対するさまざまな技術や設備、作業環境を整えてきた。国内外の各半

ROMテック

東芝情報システムは、高度化する情報機器向け組込みシステムとして、アプリケーション開発、プラットフォーム開発、高密度集積回路（LSI）設計、ライセンス、コンサル、保守など、最先端のソリューションを提供する。

LSI設計サービスでは、製造中止LSIの作り替えサービスと、LSI解析サービスを開始した。車載ソリューションでは、車載ディスプレイとスマートフォンの多機能携帯電話を双方方向接続する通信規格「MirrorLink」対応のミ

東芝情報システム

組み込みシステム開発

開発現場で生じる様々な課題に対し豊富な開発経験とノウハウを活かしたモノづくりにおけるソフトウェア全般の技術力を提供します

品質検証サービス

組込みソフトウェアの品質向上という課題に対し、キャノンで培った高レベルの品質検証サービスを提供し、品質検証プロセスの改善と効率化を実現します

Canon
キヤノンソフトウェア株式会社

URL: <http://www.canon-soft.co.jp/>
〒212-0058 川崎市幸区鹿島田890-12新川崎三井ビル
TEL:044-520-0670 FAX:044-522-5160
E-mail:embedded@canon-soft.co.jp

Embedded Technology 2012
小間No. **A-04**に出展します

ROMTEC

「半導体業界のレスキュー隊」

ロムテックには長年に渡り蓄積した「半導体メモリ」へのデータ書き込みに関する技術があります。今回はロムテックの各種サービスについてご紹介致します。お気軽にご相談下さい！

株式会社ロムテック

〒352-0005 埼玉県新座市中野2-2-22
TEL: 048-480-6022 FAX: 048-480-6021
<http://www.romtec.co.jp/>

Embedded Technology 2012

きょう開幕

新たなビジネスの機会に



組込みシステム
技術協会会長
築田 稔

「Embedded Technology (ET) 2012/組込み総合技術展」の開催にあたり、ごあいさつ申し上げます。ETはモノづくり産業を支える組込み技術のイベントとして世界最大規模を誇ります。26回目の開催となる今回は、出展407社・団体、771小間の参加を得て、会期3日間で2万3000人の来場を見込んでいます。

今年の特徴としては、対象を取り上げ、これら応用分野を意欲したカンファレンス構成と展示情報の提供などにより、新たなビジネスの機会を

を組込みの周辺技術まで広げるとともに、アプリケーションを展望することのできる「ユースケース」を設定したところ。今後、組込み技術と関連する融合成長が期待される分野として「スマートエネルギー」、「オートモティブ/交通システム」、「ロボティクス」、「モバイルクラウド」、「スマートヘルスケア」、「スマートグリッド」の6分野を取り上げ、これら応用分野を意欲したカンファレンス構成と展示情報の提供などにより、新たなビジネスの機会を

国内外から407社・団体、771小間の参加を得て、会期3日間で2万3000人の来場を見込んでいます。

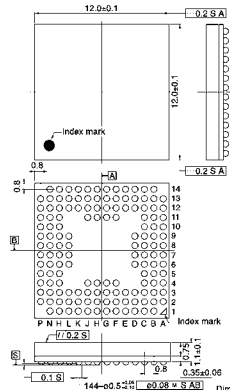
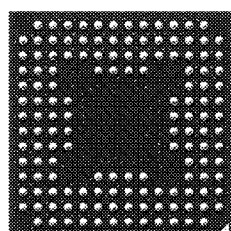
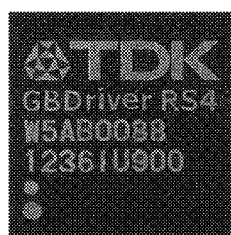
組込み技術は、その応用範囲を広げ、今後も新たな産業を創出するキーテクノロジーとして、さらに進化し続けることを確信しています。

関係各位の来場をお願い申し上げますとともに、本イベントが組込み技術のイノベーションと関連産業発展の一助となりますことを念願しております。

クラウドの未来へ、1テラバイトSSDコントローラ登場。

スマートフォンの普及によって通信量が爆発的に増大。リアルタイムデータや非構造化データが大量集積する、ビッグデータ化が急速に進んでいます。こうした課題に対して、TDKはNAND型フラッシュメモリコントローラIC「GBDriver RS4」を開発しました。最新16KB/Page構造のフラッシュメモリに対応した高速SATAコントローラICで、1チップで実効速度180MB/s、最大容量1TB（テラバイト）のSSD構築が可能となります。また、新たに搭載したエンハンスドECCにより、71bit/512Byteの強力なエラー訂正能力を装備。リードリトライ機能も備えています。クラウド社会を支えるフラッシュストレージの寿命と信頼性を高める最新鋭モデルです。

NAND型フラッシュメモリコントローラIC **GBDriver RS4** NEW



基本特性・定格	
HOST I/F	SATA 1.5Gb/s/3.0Gb/s
電源電圧	Controller I/O: 3.0~3.6V, 1.70~1.95V
動作温度範囲	Controller Core: 1.1~1.3V
	40~+85°C

『組込み総合技術展 / Embedded Technology 2012』に出展いたします。

会期 11月14日(水)~16日(金)

会場 パシフィコ横浜

ブース番号 B-01